

深南电路股份有限公司

2018 年度财务预算报告

一、行业格局及发展趋势

PCB 行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据 Prismark（2017Q3）研究报告指出，预计 2017 年中国 PCB 产值将占到全球产值的 52.3%（2016 年该数值为 50.0%），全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022 年，全球 PCB 复合增长率为 2.8%，保持温和增长的态势。中国则将以 4.2%的复合增长率保持较快增长。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)估计 2017 年半导体销售额将成长 20.6%、2018 年预计将增长 7.0%。中国半导体产业处于上升轨道，2017 年中国半导体产值估计将达到 5140 亿元，年增率达到 18.6%，维持 2010 年以来连续第 8 年双位数成长的态势。

电子信息产品将持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进 PCB 持续向高精密、高集成、高速高频化、轻薄化、高散热等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI 板、封装基板等品种的需求量将日益上升。

二、公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案集成商，成为电子互联技术领导者。

三、2018 年经营计划

2018 年，公司将继续坚持“3-In-One”战略，重点聚焦市场开拓、效率提升、募投项目建设等三大关键工作，实现各项业务稳定增长。

PCB 业务加强投入在 5G 通信领域（包括无线及数据通信）并保持先发优势，

在汽车市场开发方面取得进一步突破；持续完善质量、交付体系建设；强化专业化工厂建设，从自动化、提升各工厂资源配置效率；继续推进南通项目建设，快速推进连线试生产。

封装基板业务保持细分市场领先优势，大力开拓高速通信、存储类封装基板等市场；继续推进无锡工厂建设。

电子装联业务立足已有战略客户，继续大力拓展通信、医疗、航空航天领域优质项目；提升供应链管理能力和。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日